（上接 33 版）

⑥端－边缘侧 AI 芯片

AI MCU 芯片 CCR4001S 采用公司自主开发的 RISC-V 内核 CRV4H，主频 230MHz。CCR4001S 集成了一个 0.3 TOPS@INT8 算力的神经网络处理单元（NPU），专门用于加速 AI 任务。这一高性能 NPU 集成了卷积、池化、激活函数等多种硬件加速算子，能够高效运行 MobileNet、ResNet、VGG、EfficientNet、Yolo 等深度学习算法，使设备能够实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务。NPU 的设计还考虑到了低功耗和高性能之间的平衡，确保了在各种应用场景中都能实现卓越的表现。CCR4001S 凭借 RISC-V 内核的高效灵活性与 NPU 的专用 AI 加速能力，为 AIoT 领域提供了兼具低功耗、实时响应和边缘智能的解决方案。CCR4001S AI MCU 芯片可以应用于智能家电、智能工控、智能传感和智能检测等多种场景。

高性能 AI MCU 芯片 CCR7002 芯片采用多芯片封装技术集成了高性能 SoC 芯片子系统与 AI 芯片子系统，实现了高性能 SoC 芯片系统与低功耗 AI 芯片系统的有效结合。其中，高性能 SoC 芯片子系统搭载 64 位高性能四核 RISC-V 处理器，具有高性能、低功耗、高安全性的特点，工作频率最高可达 1.5 GHz。AI 芯片子系统采用 32 位低功耗 RISC-V 处理器，实时性强，可用于大小核协同工作完成复杂的应用任务。AI 芯片子系统集成了 NPU 神经网络处理单元，提供 0.3TOPS 算力支持。AI 芯片子系统的设计还考虑到了功耗和性能之间的平衡，确保了在各种应用场景中都能实现优良的表现。CCR7002 芯片具有高性能 CPU 处理能力，能够进行实时性任务处理，配合其 AI 芯片子系统的推理能力、丰富的外设接口，可以面向工业控制、能量控制、楼宇控制、新能源、智慧交通等领域应用。通过将计算和推理能力推向离数据源更近的位置，基于 CCR7002 芯片的边缘 AI 设备能够提供更快速、更安全的数据处理、异常检测和预测性维护能力，使得人工智能技术能够更好地应用于各种智能设备应用场景中。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

A.SoC 芯片技术的发展

SoC 设计技术始于 20 世纪 90 年代中期，随着半导体工艺技术的发展，IC 设计者能够将越来越复杂的功能集成到单硅片上，SoC 正是在集成电路（IC）向集成系统（IS）转变的大方向下产生的。原本的芯片设计思路，仅仅是在单一功能的形态下尽量做小面积，而在后期的 SoC 设计中，逐渐以将整个系统（CPU、总线、内存、高速接口）整合至一个完整芯片。在 SoC 设计中，IP 是构成 SoC 的基本单元，即先把满足特定的规范和要求并且能够在设计中反复进行复用的电路功能模块设计成 IP，以 IP 为基础进行设计，可以缩短 SoC 设计所需的周期，这个模式在过去十几年已经非常成熟。

从市场规模看，Fortune Business Insights 于 2026 年 1 月发布的《片上系统（SoC）市场规模报告》显示，2025 年全球 SoC 市场规模为 1,442.3 亿美元，预计 2026 年将增至 1,557.6 亿美元，到 2034 年有望达到 3,176.6 亿美元，2026–2034 年复合增长率 9.30%。其中，汽车应用领域预计 2026 年将占据 25.40% 的市场份额，预测期内复合年增长率达 12.56%，成为增长最快的细分赛道。OY Research 于 2026 年 2 月发布的报告进一步聚焦 AI SoC 细分市场，2025 年全球 AI SoC 市场规模约为 418 亿美元，预计到 2032 年将增至 1,071.06 亿美元，2026–2032 年复合增长率 13.5%；端侧 AI 推理模型向轻量化、高效化迁移，以及低功耗场景下实时推理与隐私保护的爆发式需求，是驱动 AI SoC 市场快速扩张的核心动因。

当前 SoC 技术正经历从“更大的芯片”向“更智能的系统”范式跃迁。Arm 公司于 2025 年 12 月发布的未来 20 项技术预测中指出，从单片芯片到模块化芯片设计的转变正在加速，通过将计算、存储和 I/O 分离成可重用的构建模块，设计人员可混合使用不同工艺节点，降低成本并更快扩展规模；新兴的开放标准（如 UCIe）将使来自不同供应商的芯粒能够可靠组合，开启可互操作组件的市场。与此同时，多协议 SerDes IP 成为应对 SoC 接口协议多样化的关键技术路径。

从产业发展格局看，端侧 AI 的爆发为国产 SoC 厂商创造了系统性成长机遇。国投证券于 2025 年 10 月发布的行业深度报告指出，2026 年或为 AI 端侧破局元年，具备更高算力、更强综合性能的 SoC 产品正为 AI 终端的规模化增长奠定技术基础。在端侧 AI 从“可运行”向“高效运行”转型的产业窗口期，具备“芯片 + 算法 + 工具链”完整闭环能力的本土 SoC 设计企业，正迎来市场份额与估值体系的双重重塑。

B.集成电路新技术工艺的催生

随着摩尔定律的不断演进，集成电路器件的工艺节点朝着先进 7nm、5nm 和 3nm 等方向不断缩小，器件微观结构对芯片速度、可靠性、功耗等性能影响越来越大。自集成电路制程进入 14nm 后，为满足性能、成本和功耗要求，制程工艺技术转向 FinFET 技术工艺，源自传统标准的晶体管－场效晶体管的一种创新技术。FinFET 的晶体管是类似鱼鳍的三维结构，可于晶体管的两侧控制电路的开路和短路，可以大幅减少漏电流并改善电路控制，主要用于高性能数字处理等场合。

从市场规模看，Global Growth Insights 于 2025 年 1 月发布的《FinFET 技术市场报告》显示，2025 年全球 FinFET 技术市场规模约为 483.8 亿美元，预计 2026 年将增至 538.6 亿美元，到 2035 年有望达到 1,413.8 亿美元，2026–2035 年复合增长率达 11.32%。该增长主要由高性能计算、人工智能处理器及移动 SoC 对先进节点的强劲需求驱动。

FinFET 具有更高的集成度和较快的速度，适合高性能以及大规模计算的产品。根据 Global Growth Insights 数据，目前超过 74% 的 AI 芯片组依赖 FinFET 技术，约 72% 的高性能计算系统已转向基于 FinFET 的设计以提升效率并降低漏电流；在智能手机领域，超过 68% 的旗舰机型处理器采用 FinFET 架构，在汽车电子领域，约 61% 的现代汽车 ADAS 系统依赖 FinFET 逻辑以满足实时处理与热稳定性要求。

集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变。2026 年 1 月，台积电正式实现 2nm（N2）制程工艺的高通量量产，标志着半导体产业正式告别 FinFET 晶体管时代、迎来全环绕栅极（GAA）纳米片晶体管的新纪元。相较于上一代 3nm FinFET 工艺，2nm GAA 在同等性能下功耗降低 25%至 30%，同等功耗下性能提升 10%至 15%。产业界正持续探索后摩尔时代的器件技术路径。

C.chiplet 芯粒互联技术的发展

随着 5nm 以下制程的单片集成成本飙升，物理极限逼近，集成电路产业逐步将“基于 IP”的设计发展至“基于芯粒”的设计，通过先进封装（2.5D/3D 堆叠，UCIe 互联）重组，将不同功能模块的“芯粒”以 IP 形式集成到一个完整的合封芯片中去，实现“不同工艺节点，不同功能模块”的异构集成，带来降低先进制程设计风险、加速上市周期、高带宽互联等显著优势。

从市场规模看，Research and Markets 于 2026 年 1 月发布的《Chiplets 市场报告 2026》显示，2025 年全球 Chiplet 市场规模为 135.5 亿美元，2026 年预计将激增至 225.8 亿美元，同比增速高达 66.7%；到 2030 年有望达到 1,685.7 亿美元，2026–2030 年复合增长率达 65.3%。这一指数级增长主要由高性能计算、AI 加速器与边缘计算的规模化部署驱动，同时 UCIe 等开放芯粒互连标准的成熟与先进封装生态的完善亦构成关键支撑。

在互连技术标准层面，UCIe 联盟自 2022 年成立以来，以年度节奏持续迭代标准体系。2025 年底发布的 UCIe 3.0 实现关键技术跃升：单通道数据传输速率从 32GT/s 翻倍至 64GT/s，二维 /2.5D 封装的边缘带宽密度提升至 2,634 GB/s/mm，先进封装（UCIe-A）功耗效率低至 0.5 pJ/bit。3.0 版本同时优化了多芯粒自动流程，显著降低系统管理延迟。上述技术演进使芯粒间互连的延迟与功耗逼近单片 SoC 内部水平，为大规模异构集成提供了标准化的“硅基乐高”底座。

在产业生态层面，芯粒技术正推动半导体供应链从“线性分工”走向“系统级再整合”。EDA 工具链同步迎来“协同设计”范式革命：2.5D/3D IC 布局布线、多物理场仿真、芯粒－中介层－封装协同优化成为新一代 EDA 平台的核心能力。随着 UCIe 3.0 核心技术细节的落地，一个真正开放、可互操作的硬件生态系统正在形成。

D.指令集开源进一步推动生态系统成熟

2010 年加州大学伯克利分校的 Krste Asanovic、Andrew Waterman、Yunsup Lee、David Patterson 等人组成的研发团队成功设计了全新的开源指令集 RISC-V，其具有极简、模块化和可扩展的特性，可设计低功耗、小面积、具有个性化和差异化的嵌入式 CPU。RISC-V 指令集于 2015 年宣布开源，允许使用者修改和重新发布开源代码。短短几年时间内，谷歌、IBM、镁光、英伟达、高通、三星、西部数据等国际主流商业机构和加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学、印度理工学院、洛伦兹国家实验室、新加坡南洋理工大学等学术机构纷纷加入 RISC-V 基金会，越来越多的国内本土公司与机构亦加入 RISC-V 架构处理器的开发中，包括阿里、中科院计算所等，业内技术水平和产业生态都有了一定的积累。

从市场规模看，Straits Research 于 2025 年 12 月发布的《RISC-V 技术市场规模与展望 2026–2034》报告显示，预计到 2034 年，全球 RISC-V 技术市场规模将激增至 261.09 亿美元，2026–2034 年复合增长率高达 42.9%。从应用领域看，微控制器以 46.72% 的占比成为最大应用场景，消费电子终端则以 41.28% 的复合增长率领跑下游市场。RISC-V 国际基金会首席执行官 Andrea Gallo 在 2025 年 7 月披露，2022 年全球 RISC-V 芯片出货量已突破 100 亿颗，基金会预测到 2031 年出货量将突破 200 亿颗，RISC-V 架构处理器在主流市场的渗透率届时将达到 25.7%。为应对国际产业环境变化，RISC-V 国际基金会于 2025 年 11 月将总部从美国正式迁至瑞士，会员规模已突破 4,000 家。

中国 RISC-V 生态近年取得里程碑式突破。北京开源芯片研究院（开芯院）于 2025 年 7 月宣布：第三代高性能开源 RISC-V 处理器核 “香山”（昆明湖）已实现首批量产客户的产品级交付，SPECCPU2006 分值达 15 分 /GHz，性能对标 ARM N2，符合 RVA23 标准，进入全球 RISC-V 处理器第一梯队。2025 年 7 月在上海举办的第五届 RISC-V 中国峰会吸引全球 17 个国家、3,000 余名产业人士参会。

RISC-V 指令集的开源特性与公司“自主可控嵌入式 CPU 技术研发”的战略方向高度契合。公司已成功研发 CRV0、CRV4/4E/4H/4L、CRV5、CRV7 系列 RISC-V CPU IP 核，并基于 RISC-V 架构推出了云安全芯片、端安全芯片、端 AI MCU 芯片及正在研发面向下一代汽车电子电器架构的高性能汽车智能域控 AI MCU 芯片 CCRC4XXX（原 CCFC3009PT）。未来公司将重点发展 RISC-V+AI 和 RISC-V+ 安全芯片技术和产品系列。

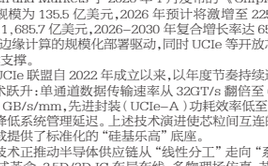
Power 指令集也于 2019 年宣布开源。Power 指令集在服务器、通信设备、航天航空、信创和信息安全、工业控制和汽车电子等领域已有广泛的应用，生态环境成熟，其开源将进一步推动基于该类指令集的应用。OpenPOWER 基金会近年来持续推动 Power ISA 开源生态建设：2025 年 7 月，基金会宣布成立人工智能特别集成小组，聚焦 AI 算法与库在 OpenPOWER 平台上的行业标准化，由瑞士 InnoBoost SA 与加拿大 CT 公司联合主持。同年 12 月，基金会与 ChipFoundry 合作举办 Microwatt 设计挑战赛，吸引全球超 300 支团队参赛，基于开源 Power ISA Microwatt 内核提交涵盖 AI 加速器、传感器应用、边缘计算等领域的芯片设计方案。上述进展表明，Power 开源社区正通过技术工作组与开源硬件竞赛加速生态活力重建。基于 Power 指令集的本土厂商的竞争力和产业生态有望在开源浪潮中进一步提升。

（2）所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势

集成电路产业的技术突破带来持续的应用迭代，改变了许多传统行业，也引导众多新产业不断进步，例如物联网、人工智能、汽车电子、边缘计算等新兴领域蓬勃发展，为集成电路产业带来新的机遇。

①物联网

近年来全球物联网产业规模迅速扩大。根据 IoT Analytics 于 2025 年底发布的《State of IoT 2025》报告，2024 年全球物联网连接数达到 185 亿台，同比增长 12%；2025 年底将增长至 211 亿台，同比增速提升至 14%。该机构预测，到 2030 年全球物联网连接数将达到 390 亿台，2035 年有望突破 500 亿台，2025–2030 年复合增长率达 13.2%。中国市场尔保持快速增长，根据 2025 世界物联网大会信息，2025 年我国物联网连接数有望突破 35 亿，建成承载物联网的 5G 基站近 480 万个。



数据来源：IoT Analytics

物联网最大的特点就是海量的互联设备和丰富应用场景，由此带来了海量的芯片需求。目前已开始实现规模应用的物联网芯片主要包括 SoC 主控芯片、通讯射频芯片和安全芯片等，其中 SoC 主控芯片、安全芯片等均需要使用嵌入式 CPU 技术，物联网应用的爆发将进一步打开嵌入式 CPU 的市场空间。从芯片市场规模看，前瞻产业研究院于 2025 年 7 月发布的《全球及中国物联网芯片行业市场调研及投资前景分析报告》显示：2024 年中国物联网芯片市场规模约 1,107.90 亿元，预计 2025 年将增至 1,259.42 亿元。

同时，物联网需求场景碎片化、多样化、个性化等特点对嵌入式 CPU 提出了新的要求，且很难使用一款通用芯片平台来满足不同应用场景的需求，而必须针对不同的场景使用专用的定制化芯片，同时还需要满足低功耗、低成本的要求。在此情形下，国际主流嵌入式 CPU 厂商无法通过某几款竞争力强的产品满足丰富的目标场景需求，而具备较强微架构定制化设计技术实力的本土厂商将迎来极大的发展机遇。公司安全芯片、端侧 AI MCU 芯片已在物联网领域实现批量出货，与上述发展趋势高度契合。

②人工智能

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）于 2025 年底发布的秋季市场展望，2025 年全球半导体市场规模达 7,722.43 亿美元，同比增长 22.5%；2026 年预计将增至 9,754.60 亿美元，同比增长 26.3%。上述增长主要由 AI 与数据中心需求驱动。在 AI 加速器细分领域，弗若斯特沙利文预测，到 2029 年全球 AI 芯片市场规模将持续高速扩张；中国 AI 芯片市场规模预计从 2024 年的 1,425.37 亿元激增至 2029 年的 13,367.92 亿元，2025–2029 年复合年均增长率达 53.7%。

近年来随着人工智能整体行业的发展，对于 AI 芯片的设计开发思路也有较大影响。从早期的如何把芯片做成“算得快”，逐步演变成涵盖解决内存墙、功耗墙、生态墙和应用墙的系列化工程。

为解决算得快的问题，业界从早期的纯 CPU 计算，逐步发展，提高乘累加器的数量，以 AI 方向 DSA 的手段解决算力的问题，出现了用 GPU、GPGPU、NPU、GPNPU 等多种形式的人工智能加速体，结合日益先进的工艺制程，一定程度上解决了“算得快”的问题，目前人工智能芯片云端算力均以数千甚至数万 TOPS 为标准。

随着“算的快”的问题的解决，内存墙和功耗墙的问题由此引申出来。由于乘累加单元数量的提升，计算得快使得内存交换带宽的需求也成比例甚至呈指数提高，出现了“内存墙”。并且由于 AI 算力密集，单位时间内热量堆积导致功耗急剧上升，出现了“功耗墙”。业界为了解决此类问题，提出了“存内计算”“近存计算”等解决方案。通过模拟计算、SRAM 存内计算、DRAM 存内计算等方式，将乘累加单元以更小更低功耗的方式实现，提高计算和存储效率，已成为业界共识的技术演进方向。

人工智能的发展离不开软件和生态的布局。英伟达早在 10 多年前就开发了 CUDA 生态，目前其凭借 CUDA 生态和并行算力主导了深度学习时代，形成了从底层的指令集架构、内核驱动，到中间层的运行时环境、编程接口、数学库，再到顶层 AI 框架的完整计算栈壁垒。国产 AI 芯片厂商普遍采取兼容 CUDA 的务实路径，但如何在兼容与自主之间建立可持续的生态体系，仍是产业界面临的核心挑战。

③汽车电子

随着汽车“四化”程度提升，汽车系统所需 MCU 的用量激增。以汽车 ECU（电子控制单元）系统需求为例，ECU 中均需要 MCU 芯片，根据中国市场学会汽车营销专家委员会研究部数据，在分布式电子电气架构阶段，普通传统燃油汽车的 ECU 数量平均为 70 个左右，豪华传统燃油汽车平均为 150 个左右，智能汽车 ECU 数量平均为 300 个左右，在向新一代电子电气架构演进过程中，单车 MCU 用量较传统燃油汽车增长 2–4 倍。

从市场规模看，Yole Group 在 2025 年 10 月发布的《微控制器行业现状报告》中指出，汽车电子已成为 MCU 最大的收入来源，2024 年全球汽车 MCU 市场规模约为 79 亿美元，预计 2025 年将同比增长 23%至 97 亿美元，2026 年有望突破 110 亿美元。随着智能驾驶辅助系统（ADAS）、新能源汽车以及自动驾驶汽车的逐步发展与推进，汽车产业为集成电路技术的长足发展提供了广阔的空间。

汽车电子是公司的核心业务方向之一。公司汽车电子芯片已覆盖域控制、辅助驾驶、动力总成、安全气囊、DSP 等 12 条产品线，2025 年实现自主汽车电子芯片业务收入达 12,650.20 万元，同比增长 82.32%，累计出货量突破 2,500 万颗。公司将持续深耕汽车电子 MCU 芯片、数模混合芯片和 DSP 芯片，积极把握汽车电子芯片国产替代的产业机遇。

④边缘计算

随着物联网、5G 等技术的飞速发展，可穿戴设备、移动智能终端、智能网联汽车和机器人等设备产生海量的数据，并且普遍要求数据处理的低时延和高可靠性，云计算集中式的大数据处理模式有时候不能完全满足需求，在某些领域边缘计算的运行效率可能更高。边缘计算使数据能够在最近端进行处理，减少云、端间的数据传输，极大提升效率，很适合高交互、大带宽的 5G 时代。此外，在各国对数据采集和传输日益敏感的环境下，边缘计算本地化处理数据为企业安全合规带来很大便利。

从全球市场规模看，Global Market Insights 于 2025 年 12 月发布的报告显示，2025 年全球边缘计算市场规模约为 214 亿美元，预计 2026 年将增至 285 亿美元，到 2035 年有望达到 2,638 亿美元，2026–2035 年复合增长率达 28%。中国市场方面，AIoT 星图研究院与视觉物联联合发布的《2025 年边缘计算市场调研报告》显示，2024 年中国边缘计算市场规模已超过 950 亿元，预计 2026 年将增长至超 1300 亿元。

公司积极布局边缘计算领域，面向端 / 边缘侧应用开展 AI 技术研发，开发 CNN20、CNN100、CNN200 系列化 NPU IP 核，其中 CNN20 和 CNN100 已完成设计并可对外授权，CNN200 系列单核算力可达 10TOPS@INT8，适用于各种边缘计算 AI SoC 芯片。

（3）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

随着智能电子系统应用需求变得更加复杂多样化，其对芯片功能和性能的需求差异化增加了芯片设计的复杂度。同时随着摩尔定律推进，采用先进工艺制程芯片设计的研发资源和成本持续增加。高额的流片成本与设计费用使得仅有少数头部厂商能够承担前沿节点研发，芯片设计产业呈现显著的资源向头部集中的趋势。

全球半导体产业在 Fabless+ 晶圆代工 + 封装测试的分工大趋势下将会持续细化分工，芯片设计 IP 和定制服务产业有望获得更进一步的发展。根据 Global Growth Insights 于 2026 年 1 月发布的报告，2025 年全球无晶圆厂 IC 设计市场规模已达 2,530.7 亿美元，预计 2026 年增至 2,879.9 亿美元，到 2035 年将达 9,218.6 亿美元，2026–2035 年复合增长率 13.8%。Persistence Market Research 同期报告显示，全球半导体 IP 市场规模 2026 年预计为 67 亿美元，到 2033 年将增至 109 亿美元，年复合增长率 7.1%。随着人工智能的发展，新的设计服务包括 IP 授权将越来越集中在人工智能领域，并且配合了 chiplet 芯粒互联技术的持续改进。SNS Insider 于 2026 年 1 月发布的报告显示，全球 Die-to-Die IP 市场规模 2025 年为 18.0 亿美元，预计到 2033 年将达 37.2 亿美元，2026–2033 年复合增长率 9.57%。从接口标准看，UCIe 已占据 53.43% 的市场份额，成为 Chiplet 架构的主流互联方案；从应用领域看，高性能计算与 AI 加速器以 41.86% 的占比成为 Die-to-Die IP 最大的下游市场。先进人工智能引擎 + 先进设计工艺 + 先进封装技术，使得 IP 和定制服务对应的业务会显著持续增加。先进封装技术的规模化应用直接拉动接口 IP 与芯粒互联 IP 的需求，为具备 Chiplet 集成能力、掌握高速 SerDes、UCIe、HBM 控制器等关键 IP 技术的设计服务企业创造了重要增长窗口。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,252,845,447.12	3,200,422,926.79	1.64	2,978,611,496.75
归属于上市公司股东的净资产	1,951,399,697.11	2,194,800,037.17	-11.09	2,439,323,360.84
营业收入	531,881,904.41	574,201,841.27	-7.37	449,375,494.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	531,567,024.53	573,815,028.24	-7.36	448,361,965.16
利润总额	-317,515,023.98	-266,307,963.74	不适用	-238,166,311.93
归属于上市公司股东的净利润	-254,125,543.99	-180,590,013.37	不适用	-168,750,322.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-294,257,453.00	-224,011,759.10	不适用	-223,686,328.09
经营活动产生的现金流量净额	-16,772,036.69	-76,423,025.02	不适用	-285,914,887.77
加权平均净资产收益率(%)	-12.31	-7.83	减少 4.48 个百分点	-6.43
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.55	不适用	-0.50
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.55	不适用	-0.50
研发投入占营业收入的比例(%)	63.23	56.26	增加 6.97 个百分点	63.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	87,274,564.81	83,305,354.32	88,055,045.00	273,246,940.28
归属于上市公司股东的净利润	-34,750,638.09	-51,660,604.49	-40,928,358.42	-126,785,942.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,529,335.09	-57,678,504.61	-64,276,223.26	-132,773,390.04
经营活动产生的现金流量净额	-21,258,685.39	73,794,345.82	95,342,310.69	-164,650,007.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,715
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波麒越创业投资合伙企业（有限合伙）	-5,167,592	21,280,448	6.33	0	无	0	其他
郑茫	0	18,527,812	5.51	0	无	0	境内自然人
肖佐楠	0	12,969,493	3.86	0	无	0	境内自然人
苏州国芯联创投资管理有限公司	0	12,961,160	3.86	0	无	0	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-5,039,997	7,964,648	2.37	0	无	0	国有法人
孙力生	0	7,457,894	2.22	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,950,802	2.07	0	无	0	其他
宁波珺璞投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,153,293	1.83	0	无	0	其他
宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）	-1,403,170	6,122,562	1.82	0	无	0	其他
匡启和	0	5,326,743	1.59	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，郑茫、肖佐楠、匡启和、苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波珺璞投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。宁波麒越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）、孙力生为一致行动人关系；未知上述其他股东之间存在一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

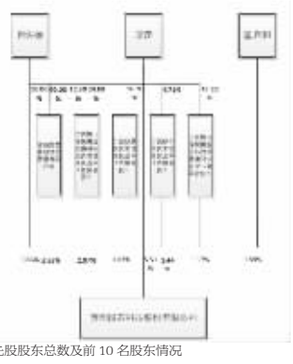
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-016

苏州国芯科技股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，以 2 票同意、1 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联委员陈石回避表决，出席会议的非关联委员一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计 2026 年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，独立董事认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中的正常往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，以 4 票同意、3 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,340.00 万元。关联董事郑茫、肖佐楠、陈石回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2026 年度发生日常关联交易合计金额为 3,340.00 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、技术服务	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,000	1.24	0	0.02	0.00	实际业务发展需要
	苏州微五科技有限公司	1,000	1.24	0	209.91	0.67	实际业务发展需要
	小计	2,000	2.48	0	209.93	0.67	
向关联人购买产品、商品、技术服务等	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,300	1.44	325.2	58.56	0.07	实际业务发展需要
	小计	1,300	1.44	325.2	58.56	0.07	
向关联人提供房租及服务（包含物业费）	苏州微五科技有限公司	11	15.71	2.57	1.71	8.62	实际业务发展需要
	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	27	38.57	4.21	10.13	51.08	实际业务发展需要
	苏州龙霖信息科技有限公司	2	2.86	0.15	0	0.00	实际业务发展需要
	小计	40	57.14	6.93	11.84	59.71	
合计		3,340	-	39.45	280.33	-	

注：1、以上数据为不含税金额；2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品、技术服务等	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,000.00	58.56	因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整
	小计	1,000.00	58.56	
向关联人销售产品、商品、技术服务等	苏州紫山龙霖信息科技有限公司	1,000.00	0.02	因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整
	苏州微五科技有限公司	1,000.00	209.91	因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整
	小计	2,000.00	209.93	
合计		3,000.00	268.49	

注：以上数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、苏州紫山龙霖信息科技有限公司

企业名称	苏州紫山龙霖信息科技有限公司
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	陈石
注册资本	3,500 万人民币
成立日期	2016年 4 月 19 日
住所及主要办公地点	苏州高新区竹园路 209 号
经营范围	计算机、服务器和仪器仪表的技术开发、自有技术转让；系统集成服务，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务；研发、销售计算机、服务器和仪器仪表的系统及零部件；并提供相关技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	广州领芯科技有限公司持股 42.8571%，陈松林持股 28.5714%，DRAGON CRUISE LIMITED（龙行贸易发展有限公司）持股 28.5714%。
主要财务数据	2025年末资产总额 2,383.69 万元，净资产 1,113.04 万元；2025 年营业收入 21.49 万元，净利润 -362.14 万元。

注：上表数据未经审计

2、苏州龙霖信息科技有限公司

企业名称	苏州龙霖信息科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈石
注册资本	100万人民币
成立日期	2019年 11 月 26 日
住所及主要办公地点	苏州高新区苏湖路 99 号 1 幢 1501 室 -13
经营范围	计算机、服务器和仪器仪表的技术开发；计算机系统集成服务；计算机维修；研发、销售计算机、服务器和仪器仪表的软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	苏州紫山龙霖信息科技有限公司持股 100%
主